证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-028

锦州神工半导体股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月29日14点00分

召开地点:公司会议室(辽宁省锦州市太和区中信路46号甲)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行的募集资金投向	√
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案	√
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	√
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
10	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案	√
11	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载会议资料。

2、特别决议议案:1-11

3、对中小投资者单独计票的议案:1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688233	神工股份	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2026年5月28日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分。

(三)登记地点:公司证券办公室。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)会议联系方式:

1、联系地址:辽宁省锦州市太和区中信路46号甲

2、联系电话:0416-7119889

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年5月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

锦州神工半导体股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格与定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	本次发行的募集资金投向			
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期			
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案			
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案			
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
8	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案			
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
10	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案			
11	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-023

锦州神工半导体股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件,敬请广大投资者注意查阅。

本次发行预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东会审议通过及上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况,按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-025

锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的有关规定,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),本次发行完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加,由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间,短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险,具体影响测算如下:

(一)财务指标计算的主要假设和前提

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境及产品市场情况等方面没有发生重大变化;

2、假设本次发行方案于2026年11月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对本次发行实际完成时间的判断,最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准;

3、假设发行数量为17,030,574股(以预案出具日公司总股本170,305,736股的10%测算),募集资金总额为100,000.00万元,本测算不考虑相关发行费用;本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

4、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润等之外的其他因素对净资产的影响;

5、公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为10,203.71万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为10,032.24万元;

6、假设公司2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按以下三种假设进行测算:1)较2025年减少10%;2)与2025年持平;3)较2025年增加10%。该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

7、假设2026年除本次发行外,不存在其他导致公司总股本变化的因素;

8、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2026年盈利情况的承诺,也不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下:

项目	2025年度/2025.12.31	2026年度/2026.12.31	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	17,030.57	17,030.57	18,733.63
本次发行股份数量(万股)			1,703.06
假设情形一:2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年减少10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,203.71	9,183.34	9,183.34
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,032.24	9,029.02	9,029.02
基本每股收益(元/股)	0.60	0.54	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.54	0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.59	0.53	0.53
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.59	0.53	0.53
假设情形二:2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2025年持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,203.71	10,203.71	10,203.71
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,032.24	10,032.24	10,032.24
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.60	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.58
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.58
假设情形三:2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年增加10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,203.71	11,224.08	11,224.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,032.24	11,035.47	11,035.47
基本每股收益(元/股)	0.60	0.66	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.66	0.65
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.59	0.65	0.64
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.59	0.65	0.64

注:每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,由于募集资金投资项目存在一定的实施周期,可能在短期内难以实现预期效益,从而存在本次发行完成后每股收益被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力,具有充分的必要性和可行性。

关于本次向特定对象发行募集资金投资项目的必要性和合理性具体分析,详 见《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》之“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于主营业务相关项目建设,募集资金投资项目属于围绕现有业务的固有产品及新产品研发、技术升级与产业化项目,有望进一步丰富公司产品矩阵,提高公司核心竞争力,增强可持续盈利能力,促进公司高质量转型发展。

公司为国内领先的硅材料、硅零部件生产企业之一,本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向,有利于提升公司的综合实力,对公司的发展战略具有积极作用。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司以“科技创新,技术报国”为宗旨,以“专注技术、强调质量、服务客户”为经营理念,致力于成为有市场地位、有技术优势和研发实力、有高性价比产品、有良好品质管理及售后服务的优秀半导体材料和半导体零部件供应商。公司将继续着眼于国际半导体行业,引进有着丰富生产、管理经验的复合型专家;同时吸纳国内有一定基础的中端技术人员;巩固并加强中国本土技术人才梯队,提升公司的人才竞争优势。截至2026年3月末,公司研发人员87人,占员工总数量的20.23%,主要研发人员均有丰富的行业工作经验。

技术储备方面,公司聚焦“硅零部件精密加工”、“半导体碳化硅涂层技术”两大核心方向,同步强化工艺智能化管控领域布局,深耕半导体级单晶硅材料及应用产品赛道,研发成果丰硕,专利申请与授权工作稳步推进,进一步夯实了公司“材料+零部件”一体化核心竞争优势,为业务高质量发展提供有力技术支撑。公司在硅零部件上的技术储备十分丰富,已有20余项核心技术。截至2026年3月31日,公司拥有107项专利,其中19项为发明专利,88项为实用新型专利。公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业等多项证书,充分证明公司的技术储备及研发实力。

市场储备方面,公司已取得了中国本土硅零部件市场的领先地位,已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链,以高端品类为主,发挥了独特的国产化作用。公司已扎根于分工严密的国际半导体供应链中,将硅材料直接销售给日本、韩国等国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商,例如美国泛林集团(Lam Research)和日本东电电子(Tokyo Electron Limited,TEL),并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商,下游产业链丰富且实力雄厚。同时公司已取得本土硅零部件市场的领先地位,已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链,以高端品类为主,发挥了独特的国产化作用,市场空间潜力大。

综上所述,公司拥有充足的人员、技术和市场储备,为顺利推进募集资金投资项目提供了充分保障。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次发行募集资金的有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的回报能力,公司拟采取一系列措施以提升公司经营业绩,为股东持续创造回报,具体如下:

(一)加强募集资金管理,确保募集资金规范、有效使用

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。本次募集资金到位后将存放于公司董事会决议开设的专项账户,并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专款专用。同时,公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定,在进行募集资金投资项目时,严格履行资金支出审批手续,明确各控制环节的相关责任,按项目计划申请、审批、使用募集资金,并及时履行相关信息披露义务。

(二)积极、稳妥地实施募集资金投资项目,实现项目预期回报

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略,可有效提升公司业务实力、技术水平,从而进一步巩固公司的市场地位,提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募集资金投资项目前期的可行性研究工作,对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和分析,结合行业趋势、市场容量及公司自身等基本情况,最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目的实施,争取早日投产并实现预期效益。

(三)不断完善公司治理,进一步提高经营管理能力

公司已建立健全了内部管理体系,能够保证公司各项经营活动得到有序开展。公司未来将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,不断完善公司治理结构,进一步提高经营管理能力,完善决策程序、优化管理流程、强化执行监督,促进公司规范运作,全面提升公司的经营效率和效果,保护公司和投资者的合法权益。

(四)持续完善内部控制,加强资金使用管理和对管理层考核

公司将进一步完善内部控制,加强资金管理,防止资金被挤占挪用于非经营性活动,提高资金使用效率;严格控制费用支出,加大成本控制力度,降低运营成本,提升公司利润率;加强对管理层的考核,将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩,确保管理层恪尽职守、勤勉尽责,保障公司持续、稳定、健康发展。

(五)完善利润分配政策,优化投资者回报机制

公司制定了详细的利润分配原则、利润分配规划与计划、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的发放、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制;在具备现金分红的条件下,公司应当优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。此外,公司还制定了《锦州神工半导体股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》,进一步明确了未来三年(2026-2028年)的利润分配政策,积极落实对股东的利润分配,促进对投资者持续、稳定、科学的回报,切实保障投资者的权益。

(六)其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

此外,公司提示广大投资者,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

六、相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺

公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下:

1、在任何情况下,不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、对本人的职务消费行为进行约束,在职务消费过程中本着节约原则行事,不奢侈、不铺张浪费;

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司未来实施股权激励计划,股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本承诺出具日后,如中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定的,本人届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺;

7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;同时,若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-026

锦州神工半导体股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》的相关要求,致力于不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向特定对象发行人民币普通股(A股)股票,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-024

锦州神工半导体股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,公司采用非公开发行股票的方式,向特定投资者发行人民币普通股10,305,736.00股,每股发行价格为人民币29.11元,募集资金总额为人民币299,999,974.96元,扣除各项发行费用合计人民币3,943,396.22元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币296,056,578.74元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]110Z0012号《验资报告》验证。

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》(以下简称管理制度),对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023年9月,公司、国泰海通证券股份有限公司(曾用名:国泰君安证券股份有限公司)与招商银行锦州分行营业部、中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

截至2026年3月31日止,公司前次募集资金余额(含银行理财)为0.00元。前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

银行名称	银行帐号	账户类别	初始存放金额(元)	余额(元)
招商银行锦州分行营业部	416900037710703	活期	210,000,000.00	已注销,零余额
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200669624	活期	86,999,974.96	已注销,零余额
合 计			296,999,974.96	

注1:初始存放金额与实际募集资金净额差异943,396.22元,系从募集资金专户中用于支付审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。

注2:募投项目之“补充流动资金”对应募集资金已全部按计划投入使用完毕。为方便账户管理,公司于2024年12月将募集资金结余利息收入0.14万元补充到公司银行存款账户,同时注销公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行开立的募集资金专户(账户号:0708004329200669624)。

注3:根据公司2026年1月23日第三届董事会第十一次会议、2026年2月10日2026年第一次临时股东会会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止,并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。为方便账户管理,公司于2026年3月将节余募集资金13,223.57万元补充到公司银行存款账户,同时注销公司在招商银行锦州分行营业部开立的募集资金专户(账户号:416900037710703)。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2026年3月31日止,本公司前次募集资金投资项目存在以下变更的情况:

根据公司2026年1月23日第三届董事会第十一次会议、2026年2月10日2026年第一次临时股东会会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止,并将节余募集资金13,223.57万元永久补充流动资金。

2023年公司决定实施“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”时公司综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素,经过充分论证制定的项目投资计划。但随着半导体行业需求变化,外部环境较决策时已发生明显变化。全球和中国的市场环境较公司规划募投项目时已发生较大变化:一方面,由于全球半导体市场的结构性行情,导致市场整体景气度恢复的时间晚于公司最初预测,该业务的产能利用率未达预期;另一方面,中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛,改变了既有的全球产业格局,公司大直径硅材料的直接下游产品硅零部件受到国产化需求带动,实现连续大幅增长,成为公司第二增长曲线,对公司水电气等基础设施配套以及人才梯队建设提出更高要求,需要资金投入。公司经综合考虑近年来市场的供需情况、行业竞争格局变化等因素,审慎决定不再继续投入原募投项目。“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”终止有利于合理利用募集资金,提高资金使用效率,不会对募投项目及公司生产经营活动产生重大不利影响。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司承诺募集资金投资金额、实际投资金额情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	21,000.00	20,905.66	8,257.64	-12,648.02
2	补充流动资金	9,000.00	8,700.00	21,971.68	13,271.68
合计		30,000.00	29,605.66	30,229.32	623.66

集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目募集后资金承诺投资金额20,905.66万元,截至2026年3月31日实际投资总额8,257.64万元,差异原因为公司经综合考虑近年来市场的供需情况、行业竞争格局变化等因素,审慎决定不再继续投入该募投项目,并将节余募集资金13,223.57万元永久性补充公司流动资金。

补充流动资金项目募集后资金承诺投资金额8,700.00万元,截至2026年3月31日实际投资总额21,971.68万元,差异原因为集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目节余募集资金13,223.57万元补充公司流动资金及购买理财产品产生的收益及利息收入投入项目所致。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,337,697.02元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了《关于锦州神工半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2023]110Z0157号)。

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至2026年3月31日,公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

(五)闲置募集资金情况说明

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币20,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币15,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币11,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截至2026年3月31日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的情况。

(六)前次募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月22日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年10月。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

根据公司2026年1月23日第三届董事会第十一次会议、2026年2月10日2026年第一次临时股东会会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止,并将节余募集资金13,223.57万元永久补充流动资金。

截至2026年3月31日止,公司前次向特定投资者发行股票募集资金已全部使用完毕,且专用账户已全部注销完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

不适用。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

(三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。